

KARTA TECHNICZNA

▶ PŁYTY IZOLACYJNE termPIR® WS GK

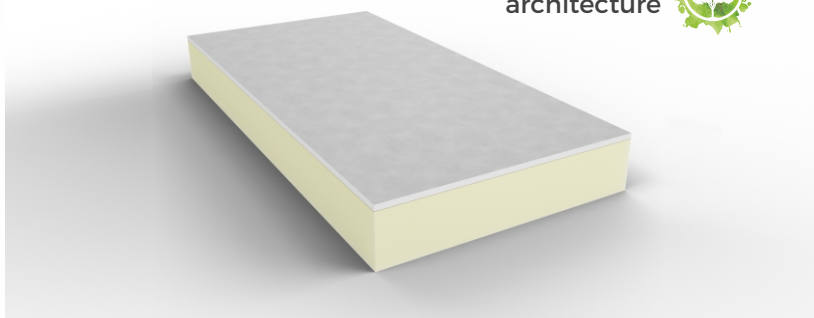


termPIR®
płyty izolacyjne

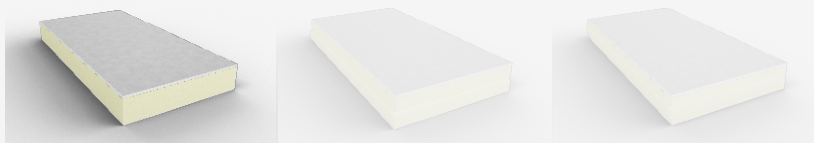
Opis płyty

Kompozytowe płyty izolacyjne **termPIR® WSGK** składają się z płyty termPIR® WS z rdzeniem z pianki PIR oraz płyty gipsowo-kartonowej. Płyty pokryte są z jednej strony gazoprzepuszczalną okładziną z welonu szklanego. Druga strona płyty pokryta płytą gipsowo-kartonową. Pomiędzy płytą termPIR® WS, a płytą g-k znajduje się warstwa adhezyjna.

Green
architecture



Wizualizacja płyt z dostępnymi frezami



Dostępne frezy

FIT (frez płaski)

LAP (frez schodkowy)

TAG (pióro-wpust)

Zastosowanie płyt termPIR® WS GK w energooszczędnych budynkach

Budynki:	Przeznaczenie płyty:	
▶ jednorodzinne, wielorodzinne	▶ dachy skośne w układzie nakrokwiowym	
▶ jednorodzinne	▶ dachy skośne w układzie podkrokwiowym	
▶ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▶ dachy płaskie - stropodachy, tarasy - montowane mechanicznie	
▶ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▶ dachy płaskie - stropodachy, tarasy - system klejony	
▶ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▶ ściany zewnętrzne trójwarstwowe	
▶ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▶ ściany zewnętrzne dwuwarstwowe w systemie ETICS	
▶ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▶ ściany piwnic i fundamentów	
▶ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▶ ściany działowe	
▶ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▶ stropy międzykondygnacyjne	
▶ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▶ podłoga na gruncie	
▶ inwentarskie, przemysłowe	▶ sufity podwieszone - zmywalne	
▶ istniejące, zabytkowe, klatki schodowe	▶ docieplenie ścian od wewnątrz	
▶ prefabrykowane odporne na korozję betonu	▶ ściany z prefabrykatów	

Legenda

 - płyta zalecana do użycia

 - płyta możliwa do użycia

Instrukcje

Płyty montować za pomocą klejenia z dodatkowym mocowaniem mechanicznym (za pomocą wkrętów typowych jak do płyty g-k, o długości dobranej do grubości płyty i typu podłoża). Klej dobrać do rodzaju podłoża i okładziny z welonu szklanego - zalecany klej poliuretanowy lub klej do styropianu. Zapoznać się ze specyfikacją kleju. Zalecana temp. montażu: 5 - 20°C. Zapewnić stabilność podłoża. Przed montażem podłoże oczyścić i (opcjonalnie) zagruntować. Szczeliny dylatacyjne pomiędzy płytami g-k po montażu płyty zafugować się i zabezpieczyć tak jak typową płytą g-k. Zostawić przerwę pomiędzy podłogą a płytą i zabezpieczyć przez podciąganiem wilgoci. Płyty przechowywać w warunkach suchych. Płyty nie są elementem nośnym.

KARTA TECHNICZNA

▶ PŁYTY IZOLACYJNE termPIR® WS GK



termPIR®
płyty izolacyjne

Właściwości		Wartości / Klasy									
Długość / Szerokość		2,6 m (±10 mm) / 1,2 m (±7,5 mm)									
Grubość całkowita (d _N + 12,5 mm)		grubość d _N * płyty termPIR® z okładziną oraz grubość płyty karton-gips 12,5 mm									
Wspł. przewodzenia ciepła, λ ₀ dla d _N * = 25 mm		0,026 [W/m·K]									
Opór cieplny, R ₀ dla d _N * = 25 mm		0,95 [W/m²·K]									
Wspł. przewodzenia ciepła, λ ₀ dla d _N * = 20 - 250 mm		dla (20 ≤ d _N < 80 mm): 0,026 [W/m·K]			dla (80 ≤ d _N ≤ 120 mm): 0,025 [W/m·K]			dla (120 ≤ d _N ≤ 250 mm): 0,024 [W/m·K]			
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	Opór cieplny: R ₀ [m²·K/W] dla d _N * = 20 - 250 mm :	20	0,75	30	1,15	40	1,55	50	1,90	60	2,30
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	Opór cieplny: R ₀ [m²·K/W] dla d _N * = 20 - 250 mm	70	2,70	80	3,20	90	3,60	100	4,00	110	4,40
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	Opór cieplny: R ₀ [m²·K/W] dla d _N * = 20 - 250 mm	120	5,05	130	5,45	140	5,85	150	6,30	160	6,70
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	Opór cieplny: R ₀ [m²·K/W] dla d _N * = 20 - 250 mm	170	7,15	180	7,55	190	8,00	200	8,40	210	8,80
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	Opór cieplny: R ₀ [m²·K/W] dla d _N * = 20 - 250 mm	220	9,25	230	9,65	240	10,10	250	10,50		

* Dotyczy grubości płyty termPIR® WS (bez doliczania grubości płyty gipsowo-kartonowej i warstwy kleju pomiędzy płytami).

Reakcja na ogień (w zastosowaniu końcowym)
Rozprzestrzenianie ognia

Klasa B-s1,d0 "nierozprzestrzeniający ognia"

Dotyczy płyt termPIR® WS GK o grubość: 20-140/12,5 mm.
Podłoże: Każdy rodzaj podłoża niepalnego i drewnopodobnego.
Mocowanie za pomocą klejenia z możliwym mocowaniem mechanicznym.
Szczegóły w klasyfikacji.

Parametry płyty termPIR® WS

Reakcja na ogień	Klasa E	
Gęstość rdzenia PIR	30 kg/m³	
Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu, σ ₁₀	dla (20 ≤ d _N < 30 mm): ≥ 120 kPa , CS(10/Y)120	dla (30 ≤ d _N ≤ 250 mm): ≥ 150 kPa , CS(10/Y)150

Parametry płyty karton-gips (na podstawie deklaracji producenta)

Reakcja na ogień	Klasa A2-s1,d0
Przewodność cieplna (dla grubości 12,5 mm)	0,25 [W/m·K]